

A 股代码：688347
港股代码：01347

A 股简称：华虹公司
港股简称：华虹半导体

公告编号：2024-007

华虹半导体有限公司

关于 2023 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.165 港币（含税），股息以港币计值和宣派，其中 A 股股息将以人民币支付，折算汇率以董事会宣派股息之日（不含当日）前一周的中国人民银行公布的港币对人民币中间价平均值 1 港币折合人民币 0.90736 元计算，金额为每股人民币 0.150 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 0.165 港币（含税）金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因系对公司所处行业特点、发展阶段及经营模式的综合考虑，公司须预留足额资金来满足研发投入、业务发展、项目建设及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 1,936,230,415.48 元人民币、截至 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润金额 1,602,638,663.75 元人民币；2023 年度母公司净利润为 926,613,086.30 元人民币、截至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润金额 2,188,820,225.02 元人民币。经董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.165 港币（含税），股息以港币计值

和宣派，其中 A 股股息将以人民币支付，折算汇率以董事会宣派股息之日（不含当日）前一周的中国人民银行公布的港币对人民币中间价平均值 1 港币折合人民币 0.90736 元计算，金额为每股人民币 0.150 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 0.165 港币（含税）金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、2023 年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

报告期内，公司盈利 1,936,230,415.48 元人民币，公司拟分配的现金红利总额为 257,142,007.25 元人民币，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 13.28%，该比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

晶圆代工行业属于技术、资本、人才密集型行业，需要大量的资本支出和人才投入，具有较高的进入壁垒。同行业竞争对手每年都将大量资金投入新厂基建、产能扩充和产品研发。在此背景下，公司需要投入大量资金用于扩充产能、提升技术水平和研发能力以保持足够的技术竞争力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司正处于加速产能扩充，提高产品供应能力和市场响应速度的重要发展阶段。公司紧紧围绕整体发展战略，持续实践先进“特色 IC+功率器件”工艺布局，持续为客户及市场提供丰富的产品选择。公司会始终以持续盈利为目标，不断提高经营管理水平，持续不断的进行技术突破，巩固并提升市场占有率，在保持合理毛利的同时，扩大公司的收入规模，为客户及股东创造价值。

（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

报告期内，公司全年实现营业收入 1,623,187.40 万元人民币，同比下降 3.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 193,623.04 万元人民币，同比下降 35.64%。结合公司目前所在行业特点、公司发展阶段和自身经营模式，公司须预留足额资金来满足研发投入、业务发展、项目建设及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。

（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司 2023 年度未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司生产经营、研发创新、项目建设及设备购置等需求。公司将继续严格按照相关法律法规和公司章程等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

（五）中小股东参与现金分红决策

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将专注于提高在行业内的竞争力，充分利用现有资源，满足业务规模的增长需求，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值。

三、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开董事会会议，审议通过了公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东周年大会审议，经批准后实施。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东周年大会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日